



金属烧结刀片

金属烧结刀的磨损速度比树脂刀片慢，但比镍刀快，最适合在BGA、软性氧化铝、碳化钛、低温共烧陶瓷 (LTCC)、铁氧体等切割应用中保持封装的形状和尺寸。

刀片厚度: 80 – 1500µm
 金刚石颗粒度: 2 – 70 µm
 锯齿状:

金属烧结刀片可以提供锯齿状以及各种边缘形状。



金刚石颗粒度 (µm)	产品	材料	粘合剂种类
45 至 55	BGA, LGA (胶带和无胶带安装方法)	FR4, 塑料和注塑	C2/R5
30 至 50	QFN (半蚀刻)	铜引线框架 + 封装	Q7/C1
35 至 45	无源和有源设备。通信模块	低温共烧陶瓷	P1/P9
35 至 45	SAW器件, RF封装	高温共烧陶瓷	P1
13 至 25	摄像头模块	玻璃/红外玻璃	P1/P5
25 至 45	陶瓷封装	氧化铝	P5/P9

金属烧结刀片物料号描述

厚度公差*	边缘形状**	外径	内径	颗粒尺寸** (µm)	厚度* M=mm, I=tenths
2 = ±.0001"	0 = 标准	2 = 4.8"	1 = 3.5"	0A = 3-6	(050) = 50
3 = ±.0002"	N = 非标准	3 = 4.7"	2 = 88.82mm	02 = 1-2	
4 = ±.0005"	锯齿状 A = x16 插槽 (for 2" 刀片) A = x60 插槽 (for 4" 刀片) B = x32 插槽 (for 2" 刀片)	4 = 4.6"	6 = 40mm	03 = 2-4	
B = ±.0003"		5 = 4.5"		07 = 6-8	
		6 = 4.4"		10 = 10	
		7 = 4.3"		↓	
		8 = 4.256"		70 = 70	
		9 = 4.0"			
		A = 3.0"			
		B = 2.5"			
		C = 2.25"			
		D = 2.188"			
	E = 2.0"				
	F = 58mm				
	H = 77mm				
	I = 60mm				
	K = 54mm				
	L = 82mm				
	M = 56mm				
	N = 75mm				
	P = 52mm				
	S = 2.75"				
	T = 78mm				
	Z = 74mm				
	W = 79mm				

示例型号	4S0 3 0 - 5 2 10 - 120-I XX	产品系列
±.0002"	标准	4.5" 外径
		88.82 mm
		10 µm 颗粒
		12 mil 厚度

* 取决于金刚石颗粒度
 ** 取决于刀片厚度和金刚石颗粒度
 其他厚度选项、直径、边缘几何形状和金刚石颗粒度可根据要求提供。